

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2025-018

苏州世华新材料科技股份有限公司

关于公司子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目实施主体：江苏世拓新材料科技有限公司
- 投资标的名称：高性能光学和集成电路高分子材料项目（具体项目名称以实际备案为准）
- 项目投资估算：根据目前初步筹备规划，项目投资总额预计约 5 亿元，其中固定资产投资约 3.5 亿元，铺底流动资金约 1.5 亿元（投资总额及投资构成具体以实际备案为准）
- 项目资金来源：公司自有或自筹资金
- 项目建设期：结合项目总体规划，预计项目开始施工后建设期约 2-3 年（建设期具体情况以实际备案为准）
- 本投资项目已经苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过，总投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 相关风险提示：
 - 本次投资涉及购买国有土地使用权，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性。
 - 项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、建设工期等均为预估数，具体数据以实际情况为准。本次投资涉及立项备案、环评、建设工程规划、建设施工等相关报批手续，还需要获得相关主管部门审批。如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
 - 该项目当前计划投资总额仅为初步预估金额，实际投资规模将根据后续项目的具体情况确定。

4、项目主要资金来源为自有或自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，项目进度可能存在受到外部融资环境变化影响的风险，并将使公司承担一定的资金风险。

5、本次投资项目建设周期较长，项目建设进度、施工情况、外部环境变化等存在一定的不确定性，可能存在项目建设延期、不能按时达到可使用状态的风险。

6、项目建设完成后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险和不能达成投资目的的风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司的战略发展规划，为打造领先的高性能光学和集成电路材料技术平台，提升公司应用于光学显示和集成电路领域的高分子材料制造能力，公司拟以全资子公司江苏世拓新材料科技有限公司（以下简称“江苏世拓”）为实施主体，在江苏扬子江国际化学工业园投资新建“高性能光学和集成电路高分子材料项目”（具体项目名称以实际备案为准，以下简称“本项目”），江苏世拓就本项目与江苏省张家港保税区管理委员会签署《投资协议书》。本项目计划投资总额约 5 亿元人民币（具体以实际备案为准），项目达产后年亩均纳税不低于 100 万元/亩。资金来源为公司自有或自筹资金。

（二）对外投资的决策与审批程序

2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司全资子公司江苏世拓新材料科技有限公司对外投资的议案》，同时提请授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的具体事宜，包括但不限于签署、修订与本次对外投资相关的协议、办理投资项目备案等事宜。本议案无需提交股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资项目的基本情况

1、项目名称：高性能光学和集成电路高分子材料项目（具体项目名称以实际备案为准）

2、投资主体：江苏世拓新材料科技有限公司

3、建设内容：购置土地、建设厂房、购置生产设备等。

4、项目地址：江苏扬子江国际化学工业园内（现江苏世拓新材料科技有限公司一期南侧、江苏中意包装有限公司东侧），项目总用地约 52 亩（实际面积以国土部门测绘为准），地块的详细位置以土地部门出具的宗地图为准。

5、项目投资估算：根据目前初步筹备规划，项目投资总额预计约 5 亿元，其中固定资产投资约 3.5 亿元，铺底流动资金约 1.5 亿元（投资总额及投资构成具体以实际备案为准）

6、项目资金来源：公司自有或自筹资金。

7、项目建设期：结合项目总体规划，预计项目开始施工后建设期约 2-3 年（建设期具体情况以实际备案为准）

三、投资协议书对手方介绍

1、名称：江苏省张家港保税区管理委员会

2、性质：地方政府机构

3、江苏省张家港保税区管理委员会与公司不存在关联关系

四、投资协议书主要内容

（一）合同对手方

甲方：江苏省张家港保税区管理委员会

乙方：江苏世拓新材料科技有限公司

（二）项目情况

乙方拟购地投资新建高性能光学和集成电路高分子材料项目（具体项目名称以实际备案为准），项目计划投资总额5亿元（具体以实际备案为准），达产后年亩均税收不低于100万元/亩。

（三）项目用地

本项目建设地点在江苏扬子江国际化学工业园内（现江苏世拓新材料科技有

限公司一期南侧、江苏中意包装有限公司东侧)，项目总用地约52亩（实际面积以国土部门测绘为准），地块的详细位置以土地部门出具的宗地图为准，用地性质为工业用地，乙方须通过招拍挂程序取得本协议所述项目地块的土地使用权，并按招拍挂成交确认价与国土部门签订《国有土地使用权出让合同》，足额缴纳土地款及相关税费。

（四）其他事项

1、本协议未尽事宜，经双方协商一致后签订书面补充协议，补充协议与本协议，以及乙方竞拍项目用地后，由乙方与甲方另行签订的书面协议，具有同等法律效力。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效。

五、对外投资目的和对上市公司的影响

公司专注于功能性材料的研发、生产和销售，经过多年深耕布局，公司已在功能性电子材料、高性能光学材料、粘接剂和高分子材料等细分领域拥有领先的技术水平和创新能力。公司本次投资项目系围绕主营业务开展，符合公司整体经营发展战略规划，将有效提升公司在光学显示和集成电路领域的高分子材料的制造能力，打造领先的高性能光学和集成电路材料技术平台，推动公司高质量发展。

公司实施本次投资项目，符合公司战略发展需要，对公司具有积极的战略意义，不会对公司日常生产经营产生不利影响，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

六、对外投资风险

1、本次投资涉及购买国有土地使用权，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性。

2、项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、建设工期等均为预估数，具体数据以实际情况为准。本次投资涉及立项备案、环评、建设工程规划、建设施工等相关报批手续，还需要获得相关主管部门审批。如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、该项目当前计划投资总额仅为初步预估金额，实际投资规模将根据后续

项目的具体情况确定。

4、项目主要资金来源为自有或自筹资金,资金能否按期到位存在不确定性,如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化,项目进度可能存在受到外部融资环境变化影响的风险,并将使公司承担一定的资金风险。

5、本次投资项目建设周期较长,项目建设进度、施工情况、外部环境变化等存在一定的不确定性,可能存在项目建设延期、不能按时达到可使用状态的风险。

6、项目建设完成后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险和不能达成投资目的的风险等。

七、本投资项目的各项后续事宜,公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求,履行相应的决策和审批程序,并履行相应的信息披露义务。

八、本次对外投资尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2025年3月27日